深圳市龙图光罩股份有限公司

公司代码:688721　　公司简称:龙图光罩

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-四、风险因素"中关于风险因素的内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。截至2025年2月28日,公司总股本133,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币53,400,000.00元(含税),占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的58.15%。公司2024年度不进行资本公积转增股本,不送红股。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

该利润分配预案已经第一届董事会第二十三次会议审议决议通过,尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	龙图光罩	688721	/

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

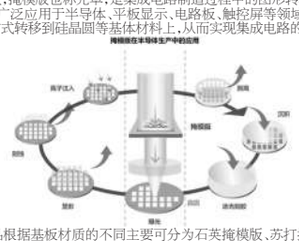
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范强	李建东
联系地址	深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4#厂房101	深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4#厂房101
电话	0755-23207580	0755-23207580
传真	0755-29480739	0755-29480739
电子信箱	ir@starmask.net	ir@starmask.net

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售,是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线,不断进行技术攻关和产品迭代,形成涵盖CAM、光刻、检测全流程的核心技术体系,产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域,终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。

公司主要产品为掩模版,掩模版也称光罩,是集成电路制造过程中的图形转移工具或者母板,承载着图形信息和工艺技术信息,广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。掩模版的作用是将承载的电路图形通过曝光的方式转移到硅晶圆等基体材料上,从而实现集成电路的批量化生产。



公司生产的掩模版产品根据基板材质的不同主要可分为石英掩模版、苏打掩模版两类,具体图示和介绍如下:

产品名称	产品图例	产品简介	应用场景
石英掩模版		以高纯石英玻璃为基材,具有高透过率、高平坦度、低膨胀系数等优点,成本较高,通常应用于高精度掩模版产品。	主要用于对精度要求高的功率半导体、模拟芯片、逻辑芯片等领域。
苏打掩模版		使用苏打玻璃作为基板材料,热膨胀率相对高于石英玻璃,平整度和耐磨性相对弱于石英玻璃,成本相对较低,主要用于中低精度掩模版。	主要用于对精度要求较低的中低端半导体制造、半导体封装、光学器件、触控屏和电路板制造等领域。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司主营业务为掩模版的研发、生产和销售,根据下游客户定制化的需要,设计和生产掩模版。公司产品主要应用于半导体领域,凭借良好的客户需求转换能力、制程能力、品质保证能力、技术服务能力等不断开拓行业内大客户、持续获取订单,实现产品销售并获得盈利。

2、研发模式

公司始终坚持自主研发和技术创新,建立了涵盖新产品开发、工艺研发、CAM软件开发、设备研发的研发体系。公司建立了《研发与知识产权内部控制制度》,规范了从项目立项、项目实施与验收的全流程。公司始终致力于探索、改进掩模版的工艺制造流程,提升产品良率,提高生产制造效率,同时对于掩模版生产所需的部分设备进行了研发、改进,从工艺到设备多角度提升掩模版产品性能。

3、采购模式

公司采购物料主要分为主料与辅料,其中主料包括制作掩模版所需要的石英基板、苏打基板以及光学膜,辅料主要为在显影刻蚀环节用到的显影刻蚀材料,以及ABS包装盒等。公司主要采取"以销定采"的方式,同时对于通用性较强的原材料,如石英基板、苏打基板、光学膜等,根据销售预测、库存情况及原材料市场供应情况适当备货。

4、销售模式

公司的主要产品具有显著定制化特征,主要采用直销模式,同时存在少量代理商销售收入,其协助公司开拓及维护中国台湾地区客户。公司依据客户对产品的规格工艺要求,通过产品成本加合理毛利并结合市场竞争情况等确定销售价格。

5、生产模式

由于掩模版为定制化产品,产品需要根据客户的个性化需求进行定制化设计与生产,因此,公司采取"以销定产"的生产模式,即根据销售订单安排生产。公司拥有包含CAM版图处理、光刻、显影、刻蚀、清洗与检测等掩模版全环节自主生产能力,凭借丰富的行业经验和领先的技术水平能够快捷高效为客户提供高质量产品与服务。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

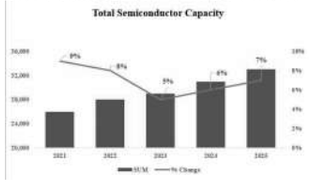
受世界经济格局的复杂性和地缘政治因素的交织影响,2024年的全球半导体行业呈现出复杂且多元的发展态势。半导体行业作为现代高科技产业与新兴战略产业的核心支柱,为现代信息技术、电子技术、通信技术以及信息化等产业构筑起不可或缺的坚实支撑体系。近年来,新能源、AI、自动驾驶、物联网、5G通信、VR/AR、元宇宙等新兴领域呈现出强劲的增长态势,促使半导体企业加快技术创新和产品升级步伐,推动了掩模版市场规模的持续扩大。

从公司主要面向的国内市场来看,面对全球贸易保护主义抬头,为抓紧打造自主可控的产业链供应链,国内企业纷纷加大在芯片制造领域的投入,并在半导体材料和设备领域不断推进国产替代,致力于构建自主可控的半导体产业链。国内芯片制造产能不断扩充,在特色工艺、成熟制程以及先进封装等领域,也不断进行产品和技术创新,带动了行业上下游的快速发展。

面对上述市场机遇,公司继续坚持"深耕特色工艺,突破高端制程"的发展战略与思路,持续人才引入、技术研发创新及市场拓展,在不断扩大现有制程范围的经营规模下,稳步推进130nm以下"高端半导体芯片掩模版制造基地"的建设投产,巩固和提升公司在半导体掩模版的行业地位,为我国半导体掩模板领域的自主可控持续贡献技术力量。

(1)半导体行业景气度上升,掩模版需求稳步增长

从全球看,根据美国半导体行业协会(SIA)最新公布的数据显示,2024年全球半导体销售额达到6,276亿美元,比2023年的5,268亿美元增长了19.1%。此外,根据SEMI在 2024年第四季度发布的《世界晶圆厂预测》报告显示,全球半导体行业从2023年至2025年计划开始运营97家新的大规晶圆厂,其中包括2024年的48个项目和2025年将启动的32个项目。全球半导体产能将进一步扩充,预计2025年年增长率将达到6.6%,每月8寸等效晶圆总量将达到3,360万片;同时,成熟的技术节点也仍在继续扩张,SEMI预计这一细分市场将增长5%,每月8寸等效晶圆总量到2025年将达到1,400万片。



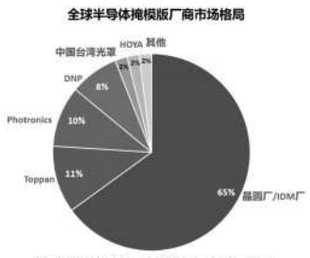
数据来源:SEMI

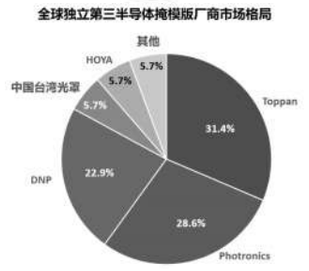
从国内看,全球贸易保护主义抬头,为保障供应链安全,国内企业加大在芯片制造领域的投入,致力于构建自主可控的半导体产业链。国内芯片制造端产能仍在继续扩张,根据SEMI数据,中国芯片制造商预计将保持两位数的产能增长,每月8寸等效晶圆总量在2024年增长15%至885万片后,2025年将增长14%至1,010万。

而作为半导体产业上游的核心材料,半导体掩模版的战略地位也将随之稳步提升。掩模版是芯片制造的"母版",其精度与质量直接决定了芯片的性能和制程水平。随着半导体产业的蓬勃发展,对掩模版的需求将不断攀升,其技术创新与产业升级也将成为推动半导体行业进步的重要力量。

(2)国产替代空间广阔,进口替代进程加速

长期以来国内半导体掩模版市场份额主要由国际巨头所占据,如美国Photronics、日本Toppan、日本DNP等。国内半导体掩模版行业起步较晚,早期面临着技术落后、设备依赖进口等诸多困境,在半导体掩模版的技术水平及产业化能力方面与美国、日本等国际先进厂商相比存在较大差距。中国大陆厂商已量产的半导体掩模版仍主要停留在350nm-130nm,130nm及以下工艺节点目前参与厂商较少。根据中国电子协会官网数据显示,目前中国半导体掩模版的国产化率10%左右,90%需要进口,高端掩模版的国产化率仅约3%。





数据来源:SEMI

然而,近年来,随着国家对半导体产业的高度重视和大力扶持,以及国内企业在技术研发上的不懈努力,我国半导体产业亦进入全方位成长阶段,产业链上下游国产替代持续推进,关键材料和设备逐步实现自主可控。国内晶圆厂的产能持续扩张,如华虹集团、芯联集成、晶合集成、长鑫存储、芯恩半导体、士兰微、立昂微、燕东微、积塔半导体、粤芯半导体、鼎泰匠芯等企业的崛起,带动了对掩模版的旺盛需求,这为国产掩模版企业提供了广阔的发展空间,众多国内掩模版厂商抓住机遇,加大研发投入,不断提升产品质量和技术水平,逐步实现了对部分进口产品的替代。

(3)半导体掩模版逆周期特征明显,行业具有较高的需求稳定性

由于掩模版产品在半导体生产中起到光刻模具的功能,可多次曝光、重复使用,因此掩模版产品需求不仅依赖于半导体行业的整体规模情况,更依赖于下游半导体行业的产品创新。半导体创新产品越多,掩模版需求量越大。国内半导体掩模版需求推动因素如下:

①半导体产品不断迭代创新:随着我国半导体芯片行业的国产替代推进,技术水平、工艺能力不断进步,芯片设计公司将会不断推出新的产品,对于掩模版的产品需求不断增加;

②半导体掩模版具有部分逆产业周期特性:当半导体行业处于下行周期,晶圆制造厂商的产能利用率不足时,为了提升产能利用率,晶圆制造厂商会向众多的中小芯片设计公司提供晶圆代工服务,从而生产的半导体产品类型亦会增多,相应增加掩模版的需求量;

③半导体产品种类繁多,应用广泛:半导体行业的产品种类繁多、工艺多样、应用广泛,不同类型的产品应用于不同的终端场景,如消费电子、人工智能、汽车电子、新能源、工业制造、无线通信、物联网等,掩模版的需求此消彼长,不会因为单个终端领域产生较大的需求波动。

(4)半导体掩模版生产工艺复杂,技术壁垒较高

半导体掩模版在光刻工艺中需要绘制的图形特征尺寸小、精度高,配套的掩模版层数多,且随着半导体工艺的不断提升,掩模版的要求也越来越苛刻,因此半导体掩模版对最小线宽、位置精度、CD精度、缺陷管控等均提出了很高的要求,工艺难度大,技术壁垒高。半导体掩模版在晶圆制造中的关键作用及制作难度决定了半导体掩模版供应商必须具备较强的制程工艺水平、精度控制能力以及完善的技术研发体系,才能满足不断升级的半导体制造的苛刻要求。

在CAM版图处理方面,光刻技术是在掩模版上制作图形的核心关键工艺,其核心目标是实现高分辨率、高精度的图形转移。以电子束光刻技术为例,它能够突破传统光刻技术的分辨率限制,达成更小的特征尺寸,满足先进制程对超精细图形的需求。然而,由于光刻过程中不可避免地会出现光学畸变等问题,这就需要运用图形补偿技术,通过复杂的算法和模拟,对设计图形进行精确的补偿,以确保最终在晶圆上形成的图形与设计要求精确匹配。

在光刻及工艺匹配技术方面,掩模版需要与光刻机的波长、分辨率、曝光方式等参数相匹配,才能实现最佳曝光效果。不同类型的下游光刻机具有不同的技术特点和参数范围,掩模版的设计和制造必须充分考虑这些因素,确保两者之间的兼容性和协同性。同时,要充分了解晶圆制造过程中的蚀刻、掺杂、光刻胶等工艺,因为掩模版上的图形最终要在晶圆上通过一系列工艺步骤转化为实际的芯片结构。只有确保掩模版上的图形能与后续工艺步骤精准匹配,才能确保产出制程与精度水平达标、符合下游客户工艺需求的半导体掩模版产品。

在检测与修复方面,掩模版在制造过程中产生的各种缺陷及各类精度偏差,与生产、传输、储存等环节中出现的污染物,会通过半导体曝光工艺传递到下游芯片上,严重影响芯片的性能与良率,且随着制程的不断提高,对缺陷尺寸的容忍度越来越低。为了确保掩模版的质量,需要借助先进的光学检测设备,对掩模版进行全方位、高精度的检测,精准检出掩模版上纳米级缺陷,包括但不限于诸如针孔、颗粒、图形畸变等微小缺陷,并在不产生二次污染的情况下通过激光或电子束去除缺陷和精准修补,技术难度较高。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在第三方半导体掩模版市场,境内厂商与境外厂商的技术差距可以体现在特色工艺、成熟制程与先进制程几个层次:

①在特色工艺制程领域,对于130nm及以上制程节点的半导体掩模版,以公司为代表的境内厂商工艺技术水平已经达到国际一线竞争对手同等水平,产品关键参数无明显差异,性能水平基本相当,正逐步占据该制程节点下境外厂商的市场份额;

②对于130nm-28nm制程节点的成熟制程半导体掩模版产品,该领域是包括公司在内的当前境内第三方厂商技术攻关和产品研发的主要方向,目前与国际一线厂商各个环节上尚存在一定差距,但是短期内技术追赶存在较大的可能;

③对于28nm及以下的先进制程节点的半导体掩模版,由于境外掩模版厂商具有资本投入的先发优势和产业链集群优势,同时中国大陆半导体行业受贸易制裁、出口管制等因素影响,目前我国境内第三方掩模版厂商暂时无法涉及28nm及以下制程节点的先进制程掩模制造,仅有极少数头部晶圆厂具备相应制版技术。

公司已经实现了130nm工艺节点半导体掩模版的量产,更高制程节点的第三代掩模版PSM产品已研发试制成功并送往客户验证。公司与国内重点的晶圆厂及设计公司均建立了深度的合作关系,技术实力及工艺能力在国内第三方半导体掩模版厂商处于第一梯队。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

集成电路作为信息产业的基础和核心,是关系国民经济和社会发展全局的战略性、基础性、先导性产业,是新质生产力的发动机,其产业链主要包括集成电路设计、设备材料、芯片制造和封装测试。未来十年,中国半导体芯片行业有望迎来产业升级与自主可控的黄金时期,产业结构将逐步优化升级。在海外技术封锁和贸易摩擦等不确定性因素增加的背景下,我国半导体芯片产业加速进口替代,实现半导体芯片产业自主可控已上升到国家战略高度,中国半导体芯片行业发展迎来了历史性的机遇。

在科技发展日新月异的当下,AI行业和机器人正呈现出快速发展的态势。以ChatGPT 4和Deepseek为代表的大语言模型、Sora等生成式AI、人形机器人等已经掀起了人工智能技术的革新浪潮。这些新兴技术的发展和应用,将逐渐渗透到各个行业与领域,带动对计算芯片、光通信、传感器、驱动芯片、电力电子等半导体产品的巨大需求,给半导体掩模版行业带来大量需求。

以SiC 和 GaN 为主的第三代半导体材料,将持续深化发展。第三代半导体材料可以制造高耐压、大功率的MOSFET、IGBT 等电力电子器件,用于高铁、智能电网、新能源汽车、快充等行业。未来,随着第三代半导体芯片应用市场的增长,半导体芯片的成本因生产技术的不断提升而下降,其应用市场也将迎来爆发式增长,给半导体掩模版行业带来新的发展机遇。

半导体芯片在封装技术领域持续发展,各种先进封装技术和形式不断涌现。SiP系统级封装、硅通孔(TSV)、2.5D、3D、异构集成、扇出型、FOWLP、FOPLP、RDL、Chiplet技术正在为人工智能、高性能计算(HPC)、数据中心、自动驾驶汽车、5G和消费电子等领域带来更大的性能提升。先进封装的成长性要高于传统封装,根据Yole数据显示,2023年至2029年全球先进封装市场规模预计从378亿美元增至695亿美元,年复合增长率达10.7%。未来,随着半导体芯片先进封装市场的增长,半导体先进封装用掩模版将迎来重要发展机遇。

(2)半导体掩模版行业发展趋势

①随着半导体技术节点的进步,半导体掩模版最小线宽及精度要求不断提升

半导体产品随着工艺技术进步和性能提升,线宽越来越窄,对上游掩模版的工艺水平和精度控制能力提出了更高要求。为了解决掩模版制作过程中由于线宽逐步缩小带来的诸多难题,以OPC光学邻近效应修正技术、PSM相移掩模版技术、电子束光刻技术为代表的一系列图形分辨率增强技术兴起并快速发展。

②芯片光刻层数增加导致掩模版的张数增加,数据处理难度加大、套刻精度控制要求更高

随着终端产品的功能日趋复杂,半导体产品的集成度持续提高,晶圆制造的工艺不断进步。随着芯片堆叠层数的增加,半导体器件与集成电路的电路图也越发复杂,晶圆表面需要光刻的图案由传统的二维电路图像发展成含有多层结构的三维电路图像,这也导致半导体掩模版的张数不断增加,CAM版图处理的难度进一步加大,掩模版的套刻精度控制也更加困难。

③特色工艺半导体快速发展,对掩模版定制化要求越来越高

近年来随着新能源汽车、光伏发电、自动驾驶、新一代移动通信、人工智能等新技术的不断成熟,特色工艺半导体行业发展迅速。特色工艺不完全依赖缩小晶体管特征尺寸,而是聚焦于新材料、新结构、新器件的研发创新与运用,强调定制化和技术品类多元性。由于下游特色工艺半导体高度定制化、平台繁多、种类庞杂、领域众多,且通常会集成多种功能,这对于第三方掩模版厂商的定制化服务能力提出了更高的要求,掩模版厂商需要有足够的技术储备才能满足快速发展的特色工艺半导体的定制化要求。

④凭借规模和技术专业化优势,独立第三方掩模版厂商市场份额增加

半导体掩模版行业具有显著的资本投入大、技术壁垒高、高度依赖专有技术的特点。晶圆制造厂商自行配套掩模工厂,主要是出于信息保密和制作能力的考量。随着制程工艺逐渐成熟及第三方掩模版厂商的制作水平的不断提升,自建掩模工厂的诸多不足逐渐体现,如设备、人工投入巨大,生产环节复杂,成本昂贵等。第三方半导体掩模版厂商能充分发挥技术专业化、规模化优势,具有显著的规模经济效应,在技术水平、产品性能指标符合要求前提下,独立第三方掩模版厂商对晶圆制造厂商的吸引力不断增加。

此外,由于掩模版承载着芯片设计方案和图形信息,涉及到芯片设计公司的重要知识产权,第三方半导体掩模版厂商作为芯片设计与芯片制造的中间桥梁,能够更好地发挥信息隔离功能,芯片设计公司更倾向于将芯片设计版图交给第三方掩模版厂商以保证自身的信息安全。总体来看,随着技术水平不断提高,第三方独立掩模版厂商竞争优势将不断体现,市场份额将持续增加。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,313,154,265.85	631,586,182.24	107.91	513,820,965.72
归属于上市公司股东的净资产	1,203,865,425.06	553,243,259.26	117.60	464,659,083.41
营业收入	246,503,467.92	218,292,698.54	12.92	161,541,554.00
归属于上市公司股东的净利润	91,832,934.36	83,608,662.12	9.84	64,482,072.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,359,606.47	81,786,730.18	10.48	61,055,740.06
经营活动产生的现金流量净额	109,234,813.58	101,478,132.25	7.64	71,156,585.13
加权平均净资产收益率(%)	11.68	16.35	减少4.67个百分点	28.55
基本每股收益(元/股)	0.83	0.84	-1.19	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.84	-1.19	0.67
研发投入占营业收入的比例(%)	9.35	9.24	增加0.11个百分点	9.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	59,722,917.50	64,173,253.31	63,067,098.65	59,540,198.46
归属于上市公司股东的净利润	24,762,752.93	24,574,423.53	22,231,682.50	20,264,075.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,741,766.45	24,293,332.30	21,997,273.82	19,327,233.90
经营活动产生的现金流量净额	23,510,981.86	23,000,889.05	24,590,106.31	38,132,836.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,823
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,627
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶小龙	0	26,366,670	19.75	26,366,670	无	0	境内自然人
柯汉奇	0	26,366,670	19.75	26,366,670	无	0	境内自然人
张道谷	0	19,586,700	14.67	19,586,700	无	0	境内自然人
厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,882,500	3.66	4,882,500	无	0	境内非国有法人
深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	4,882,500	3.66	4,882,500	无	0	境内非国有法人
上海国方私募基金管理有限公司-上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙)	0	4,500,000	3.37	4,500,000	无	0	境内非国有法人
深圳市奇龙谷投资合伙企业(有限合伙)	0	3,766,680	2.82	3,766,680	无	0	境内非国有法人
王日升	0	2,259,990	1.69	2,259,990	无	0	境内自然人
深圳市众志赢投资合伙企业(有限合伙)	0	2,259,990	1.69	2,259,990	无	0	境内非国有法人
宁波瑞扬弘创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,250,000	1.69	2,250,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)柯汉奇、叶小龙、张道谷之间签署《一致行动人协议》存在一致行动关系,柯汉奇为奇龙谷合伙执行事务合伙人。(2)除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

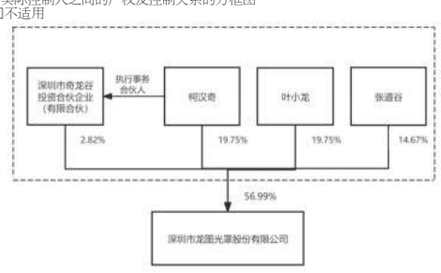
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入24,650.35万元,较上年度增长12.92%;公司实现归属于母公司所有者的净利润9,183.29万元,较上年度增长9.84%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,035.96万元,较上年度增长10.48%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688721　　证券简称:龙图光罩　　公告编号:2025-010

深圳市龙图光罩股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会同意注册(正监许可〔2023〕2929号《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》),公司于2024年8月6日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,337.50万股,发行价格为每股18.50元,募集资金总额为人民币61,743.75万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币6,397.50万元后,募集资金净额为人民币55,346.25万元。上述募集资金已到位,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2024年8月1日出具了《验资报告》(中兴华验字〔2024〕第010053号)。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2024年12月31日,公司对募集资金项目累计投入52,369.05万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,628.75万元;于2024年8月1日起至2024年12月31日止使用募集资金人民币14,740.30万元;本年度使用募集资金52,369.05万元。截止2024年12月31日,募集资金余额为人民币3,049.48万元。具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	类别	序号	金额
募集资金净额		A	55,346.25
截止期初累计发生额	募投项目投入	B1	--
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	B2	--
	未到期的现金管理金额	B3	--
本期发生额	募投项目投入	C1	52,369.05
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	C2	72.28
截止期末累计发生额	募投项目投入	D1=B1+C1	52,369.05
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	D2=B2+C2	72.28
	未到期的现金管理金额	D3	--
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	3,049.48
实际结余募集资金		F	3,049.48
差异		G=E-F	--

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确的规定。

前述募集资金到账后,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")于2024年8月分别与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行、招商银行股份有限公司深圳沙井支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时,保荐机构、公司及公司子公司珠海市龙图光罩科技有限公司与招商银行股份有限公司珠海信息港支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下均简称"监管协议")。监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

开户名称	募集资金开户银行	账号	余额
深圳市龙图光罩股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳市民中心支行	8110301080100999999	10.89
深圳市龙图光罩股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳沙井支行	755918158910888	183.40
深圳市龙图光罩股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	4000032529202168443	9.95
珠海市龙图光罩科技有限公司	招商银行股份有限公司珠海信息港支行	656901320810006	2,845.24
合计	/	/	3,049.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投资金投资项目的资金使用情况

募投项目资金使用情况详见"附件1《募集资金使用情况对照表》"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金人民币37,628.75万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币577.10万元(不含增值税)置换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项核验,并出具了《深圳市龙图光罩股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(中兴华核字(2024)第590003号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金,以及不超过人民币30,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日止,公司无使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品。

截至2024年12月31日止,公司尚未使用完毕的募集资金余额为3,049.48万元,存放在公司指定的募集资金监管账户中。募集资金投资项目尚处于建设阶段,尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目及按照相关规定使用。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日止,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日止,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止,本公司不存在变更募投项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,对募集资金进行了专户存放和专项使用,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市龙图光罩股份有限公司募集资金年度存放与实际使用的鉴证报告》(中兴华核字(2025)第590008号),认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中的相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:2024年度公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市龙图光罩股份有限公司　　2024年度　　单位:人民币万元

募集资金净额				55,346.25			本年度投入募集资金总额					52,369.05	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					52,369.05	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达